

LED/ICダイ・アタッチ用 導電性Ag樹脂ペースト MD-2000

主な用途

- ・ High-Power LED
- ・ 小型IC

特徴

- ・ 1液無溶剤型
- ・ 糸引き、液だれのない優れた作業性
- ・ 高接着力、高導電性

一般特性

ペースト特性	比重		4.1
	粘度		11000~13000 cP
	チクソ性		5.0
	オープンタイム		24時間
	有効保存期間		1年間 (-40℃)
硬化条件	オープン硬化		90分×150℃
ペースト塗布方法	スタンピング		○
	ディスペンス		○
硬化物の物性	ガラス転移点		128℃
	熱膨張係数	α1	ガラス転移点前 46 ×10 ⁻⁶ /℃
		α2	ガラス転移点後 122 ×10 ⁻⁶ /℃
	体積抵抗値1)		0.1×10 ⁻⁴ Ω·cm
	熱伝導率1)		25 W/m·K
	ダイシェア強度1)2)	25℃	15 kgf/die
260℃		1.2 kgf/die	
1)硬化条件：オープン硬化 90分×150℃			
2)1.5 mm角Siチップ、Ag/Cu基板使用			

丸の内化学株式会社
MARUNOUCHI CHEMICALS, K.K.